

CMP用スラリー (CMP Slurry)

MSW2000™

MSW2000™ は、メタル配線間のコンタクト／ビア部に主に使われているタンゲステンでのCMPスラリーです。アルミナ砥粒を含むコンポーネント (A-Part) と、酸化剤・界面活性剤を含むコンポーネント (B-Part) で構成され、ご使用時に混合してお使いいただく仕様となっております。

This slurry is used for W-CMP metal interconnect, contact/via hole. The package includes two components, one is abrasive part (Alumina / A-part) and another is chemical part (B-part) including oxidizer and surfactant.

特長 (Benefits)

- 酸化膜との高い選択比 (High selectivity to oxide)
- 高研磨レート (High removal rate)
- 高平坦性 (High planarization efficiency, low dishing/erosion)
- 高安定性酸化剤 (High oxidizer stability)
- 低腐食性 (Low corrosion)

※MSW2000™ は Rohm and Haas Electronic Materials 社の商標です。

